

Programm PCB & EMS Marketplace | Speakers Corner, Halle B3

Dienstag 14.11.2017

- 13:00-13:10 Uhr **Transforming the Electronics Industry - Bits of RFID for valuable data and more** | Alexander M. Schmoldt, RFID Valuecreators
- 13:15-13:45 Uhr **The Digital SMT Line - A Blueprint for Electronics Industrie 4.0** (incl. Video from the line) | Thomas Mueckl, Zollner Elektronik
- 13:50-14:10 Uhr **The Data Highway - RFID Reader Writers and Middleware for quick qualified data** | Olaf Wilmsmeyer, Harting RFID
- 14:15-14:40 Uhr **Creating the PCB 4.0 with RFID - Is there a smarter way towards Industrie 4.0?**
Alexander M. Schmoldt, Murata
- 14:45-15:10 Uhr **Much more than Traceability 4.0 - Embedding RFID into the PCB**
Gernot Seeger, Beta LAYOUT
- 15:15-15:40 Uhr **The Conscious Factory - the Nokia way towards Industrie 4.0**
Claus Heller, Nokia (NSN)
- 15:45-16:10 Uhr **"Some like it hot": Reflow 4.0 communicates data with the PCB**
Paul Wild, Rehm Thermal Systems
- 16:15-16:45 Uhr **Panel Discussion with all members of the consortium**
Moderation Maria Robles Consée, Editor in Chief Productronic
- 16:45-17:05 Uhr **Order Controlled Production – when products control production networks**
Gero Adrian, DXC.technologies
- 17:00-17:15 Uhr **Final Discussion and Movie of the SMT Line 4.0** | All

Mittwoch 15.11.2017

- 09:30-10:00 Uhr **Laser-based Processing of PCBs, Substrates and Interposers**
Dirk Müller, Coherent
- 10:00-10:30 Uhr **2D/3D AOI-Konzepte und Möglichkeiten**
Jens Kokott, GÖPEL electronic
- 10:30-11:00 Uhr **Warum nur Stichproben Röntgen wenn auch eine 100% Kontrolle möglich ist? Vergleich Stichprobe vs. automatische 100% Kontrolle**
Andreas Türk, GÖPEL electronic
- 11:00-12:30 Uhr **Erfolgslösungen mit Keramik – Basistechnik für elektronische Mikrosysteme**
Dirk Schönherr, Lust Hybrid-Technik et al.
- 12:30-13:00 Uhr **Automatisierte Preisanfragen und Bestpreiserecherche verkürzen Baugruppenkalkulation und Angebotserstellung**
Carmen Escherich, Bay-Soft - Best Price Engine
- 13:00-13:30 Uhr **LITESURF: Tin-free Press-in Technology for the Automotive Industry**
Dr. Frank Schabert, TE Connectivity
- 13:30-15:00 Uhr **Services in EMS: Dienstleistungen Backstage – Mehrwert für den Erfolg**
Michael Velmeden, cms electronics et al.

Donnerstag 16.11.2017

- 10:00-10:30 Uhr **Ergebnisse aus der Technischen Kommission des ZVEI**
Bernd Enser, Sanmina, ZVEI
- 10:30-11:30 Uhr **Bauteilsauberkeit**
Dr. Marc Nikolussi, Robert Bosch | Harald Hundt, Vacuumschmelze
- 11:30-12:30 Uhr **Design Chain in der Elektronikfertigung: Prozessverständnis für die Elektronik von Morgen**
Harald Pasterk, cms electronics | Erich Baumgartner, CCS - Customer Care & Solutions | Michael Sturm, Weidmüller | Arnold Wiemers, Ifa, Leiterplatten-Akademie | Markus Biener, Zollner Elektronik
- 12:30-13:00 Uhr **ZVEI Technology Roadmap - Electronic and Electromechanical Components**
Dr. Andreas Lock, Robert Bosch | Bernd Enser, Sanmina
- 13:00-13:30 Uhr **Die Leiterplattenindustrie - Aktuelle Markttrends und Aussichten**
Michael Gasch, Data4PCB
- 13:30-14:00 Uhr **Neue Kupferwerkstoffe für Einpresskontakte**
Dr. Robert Zauter, Wieland Werke
- 14:00-14:30 Uhr **PCB Lamination - Challenges of today and tomorrow**
Uwe Postelmann und Manfred Schmitter, Maschinenfabrik Lauffer
- 14:30-15:00 Uhr **Cladding Cool! Metal hybrids - "First aid" for heat management solutions**
Carina Franken, Wickeder Westfalenstahl
- 15:00-15:30 Uhr **Connected factory for full process innovation - Panasonic total solutions for smart factory** | Hiroyuki Nagai, Panasonic Factory Solutions
- 15:30-16:00 Uhr **Flexible by Design – Adhesives for FPC**
Dr. Graham Farmer, GTS Flexible Materials
- 16:00-16:30 Uhr **Why PCB waterproofing will be a standard feature within 2 years and the new technology to make it happen** | Edward Hughes, Aculon

Freitag 17.11.2017

- 10:00-10:30 Uhr **Ultra-low Dk material for high-speed & low-loss applications**
Tamara den Daas, Ventec International Group
- 10:30-11:00 Uhr **Parylenebeschichtung - Dauerhafte Versiegelung elektronischer Baugruppen mit extremen Anforderungen** | Rudolf Heicks, Heicks Industrieelektronik
- 11:00-11:30 Uhr **The Electronics & PCB Market Mega Trend**
Micha Perlman, Orbotech
- 11:30-12:00 Uhr **Wie „Big Data“ in der Baugruppeninspektion das „Time to Market“ verkürzt**
Michael Muegge, Viscom
- 12:00-12:30 Uhr **PCB Production Solutions in an Evolving Market**
Micha Perlman, Orbotech

Unser Messestandort: ZVEI Lounge im Atrium Halle B1